

國立中興大學技術授權遴選廠商公告資料表

公告主旨：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	公告日期：108/05/06
公告編號： 108-023	
內容：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	
一、技術名稱(Know-How)：將還原氧化石墨烯層修飾於孔洞表面的方法	
二、專利資訊：美國專利證號 <u>US 9105696 B1</u>	
三、技術來源：本校研發成果	
四、技術內容： 將石墨合成氧化石墨烯，接枝於基材表面(特別是孔洞的孔壁上)，然後將其還原成石墨烯，使基材具有導電性，便可以進行直接電鍍。由於全製程都是以水當溶劑，因此相當環保。製程步驟只有4步，相對一般的無電電鍍製程，製程短、廢液少，不具有有毒物質或是貴重金屬。由於石墨烯是二度空間的導體，因此它在基材表面的批覆性相當好，使得產品的良率可以大幅提升。	
五、計畫執行機關/系所：化學工程學系 技術發明人：竇維平教授、張世誠	
六、廠商資格： 1、廠商業別：晶片封裝廠、特用化學供應商、電路板廠、鋰電池廠、散熱片製造廠 2、應具備之專門技術：化學及電化學背景 3、應有之機具設備：電鍍設備 4、應有之研究或技術人員人數：2~3人 5、其他：無	
七、預期利用範圍及產品：3D 晶片電鍍、電路板電鍍、鋰電池負極材料、散熱片電鍍	
八、公開方式： (一) 技術資料於網際網路上公開。 網址：國立中興大學首頁 http://www.nchu.edu.tw/index1.php 國立中興大學產學研鏈結中心 http://140.120.49.189/about1.php (二) 逕向國立中興大學產學研鏈結中心葉小姐及黃小姐索取相關資料。	
九、申請方式： (一) 由網際網路下載申請表格，填妥後逕送至國立中興大學產學研鏈結中心。 (二) 亦得逕至中興大學索取技術資料及申請表格， 地點：台中市興大路145號(國農中心大樓2F 234室) 承辦人員：葉小姐/黃小姐 聯絡電話：(04)22851811#21.20 傳真：(04)22851672 e-mail： jmine3388@nchu.edu.tw 、 yenling@nchu.edu.tw	